

(0,80mm) .0315"

HSEC8-RA 系列

弯角 EDGE RATE™ 卡插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?HSEC8-RA

绝缘体材料:

黑色液晶

聚合物

触点:

镀铜

电镀:

在 50μ"

(1.27μm) 镍上镀金或锡

额定电流:

30°C 温升时为 3.1A

(如需详细信息, 请浏览网站)

工作温度:

-55°C 至 +125°C

卡插入深度:

(3.15mm) .125" 标称

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

最大加工温度:

230°C 下持续 60 秒, 或

260°C 下持续 20 秒, 3 次

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (10-60)

配接:

1.6mm 厚度的卡,

EEDP、HSC8、HSF8



紧固型 Edge Rate™
触点设计确保
信号完整性

接受
(1.60mm)
.062" PCB
厚度

(0.80mm)
.0315"
间距

每排最多 60 个位置

可选板锁

HSEC8

1

每排
位置数

卡厚度

电镀
选项

RA

其他
选项

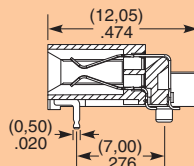
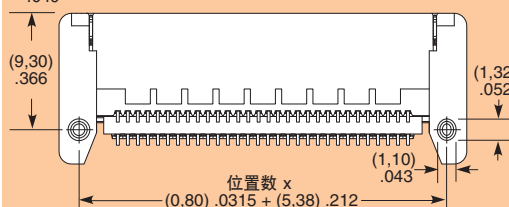
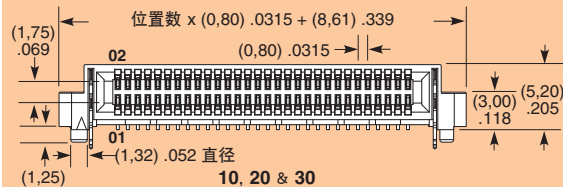
10, 20, 30, 40, 50, 60

-01
= (1.60mm) .062"
厚度的卡

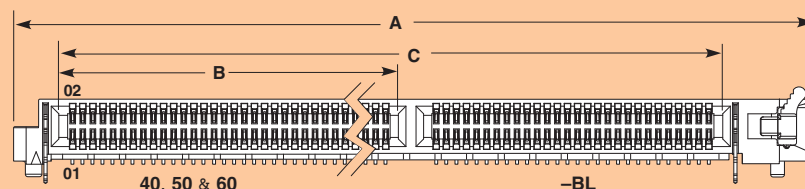
-S
= 触点镀 30μ" (0.76μm)
的金, 焊尾镀锡

-BL
= 板锁
(仅限 40、
50、60)

-TR
= 卷带封装
(仅限 10 到 60
个位置)



每排位置数	A	B	C
40	(43.80) 1.724	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50	(51.80) 2.039	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60	(59.80) 2.354	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071
40-BL	(51.30) 2.020	(18.90) .744	(36.60) 1.441
50-BL	(59.30) 2.335	(22.90) .902	(44.60) 1.756
60-BL	(67.30) 2.650	(26.90) 1.059	(52.60) 2.071



注: 提供其他镀金选项
请联系 Samtec。

注: 有些长度、式样和选项为
非标准型, 不可退换。